

FutureNet MA-E370/L

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、FutureNet MA-E370/Lのご紹介です。



FutureNet MA-E370/L

センチュリー・システムズ株式会社

ISDN・PHSマイグレーション用M2Mゲートウェイ



スペック

製品名	FutureNet MA-E370/L
内蔵モジュール	AMM570
サイズ	W174×D137×H37.2 mm ※突起物除く
重量	約840g
通信方式	LTE
通信機能	パケット通信
電源電圧	DC12V (ACアダプタ入力：AC100～240V 50/60Hz)
消費電流	DC12V入力時 最大0.95A
外部インターフェース	Ethernet (10/100TX/1000T)×2、アナログTEL×2、モデムポート(DCE)、RS-232、LINE IN、LINE OUT、USB2.0、コンソールポート、SDカード
制御コマンド	WebブラウザによるGUI設定 TELNET接続によるCLI設定
動作環境	動作温度：0°C～50°C 保存温度：-20°C～70°C 湿度：10～90% (結露なきこと)
その他機能	TI Sitara AM3352(ARM Cortex-A8 core)、DRAM1GB、Linuxカーネル3.14.x、モデムエミュレート機能、アナログモデムリレー機能、SIPサーバ機能、マルチキャリア対応

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.centurysys.co.jp/products/linuxserver/mae370l.html>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。